

# 比选公告

遂宁宏明华瓷科技有限公司（以下简称“比选人”）拟通过公开比选方式择优选聘设备供应商，相关情况如下：

## 一、委托的主要内容

比选人拟采购以下设备，敬请提供技术、服务及报价信息。

设备项目名称	PTC 芯片焊装线设备
设备需求数量	一套
主要设备技术要求	<p>一、芯片组装焊接</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、瓷片规格：10D/14D/20D</li><li>2、引线规格 CP 线，0.65—1.0mm</li><li>3、插片高度：<math>\varnothing</math>05~14mm 直脚型号 HD 范围 6~12mm</li><li>4、要求实现自动上料以及自动焊接功能</li></ol> <p>二、涂装</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、采用湿法涂装</li><li>2、粉脚长度 5mm 以下</li><li>3、涂层厚度：1mm 以下</li></ol> <p>三、固化</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、实现 PTC 芯片涂层表面加热固化功能</li><li>2、加热温度不超过 200℃</li><li>3、生产效率不低于 200 个/分钟</li></ol> <p>四、编带包装</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、对应产品规格：320mmX14.5mmX0.75mm</li><li>2、实现自动上料、反贴、纸带冲孔、人工收料功能</li></ol>

## 二、对比选申请人的资格要求

- 1、在中华人民共和国境内注册，遵守国家法律、法令和条例，具备有效营业执照，具有独立法人资格的企业或单位。
- 2、参与投标的公司具有良好的商业信誉。
- 3、参与投标的公司具有依法纳税的良好记录。
- 4、本项目不接受联合体比选申请。

## 三、比选报名

请于 2023 年 10 月 13 日至 10 月 18 日 14 时，将电子版报名文件发送至指定邮箱报名并领取比选资料。

## 四、报名需提交的材料

- （一）营业执照副本原件（留加盖鲜章的复印件）；

(二) 单位介绍信原件或授权委托书原件;

(三) 经办人身份证原件 (留加盖鲜章的复印件);

## 五、递交比选申请文件地点及截止时间

接受比选申请文件的截止时间为 2023 年 10 月 18 日 14:00, 比选申请文件必须在此规定时间之前送达四川省遂宁市栖凤中路 4 号遂宁宏明华瓷科技有限公司设备工程部。比选申请文件正本一套副本一套(统一进行密封), 文件袋标注项目、单位名称, 密封条加盖单位鲜章。迟到的比选申请文件、未按照要求密封的比选申请文件无效。

比选人定于北京时间 2023 年 10 月 19 日 14:00 在四川省遂宁市栖凤中路 4 号遂宁宏明华瓷科技有限公司会议室举行比选会议, 比选人邀请递交比选申请文件的供应商到现场监督, 供应商法定代表人或授权代理人在会议签到表上签字确认。

以上内容如有变化, 比选人将另行通知。

## 六、公告发布

本次比选公告发布媒介:

成都宏明电子股份有限公司 (<http://www.chinahongming.com>)

遂宁宏明华瓷科技有限公司 ([www.chinocera.com](http://www.chinocera.com))

## 七、联系方式

比 选 人: 遂宁宏明华瓷科技有限公司

地 址: 遂宁市栖凤中路 4 号遂宁宏明华瓷科技有限公司

邮政编码: 629000

联 系 人: 张先生

联系电话: 15828219352

电子邮箱: [zhangruixin@chinocera.com](mailto:zhangruixin@chinocera.com)